

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】令和4年2月7日(2022.2.7)

【公開番号】特開2020-166029(P2020-166029A)

【公開日】令和2年10月8日(2020.10.8)

【年通号数】公開・登録公報2020-041

【出願番号】特願2019-63799(P2019-63799)

【国際特許分類】

G 09 F 9/00(2006.01)

10

H 01 L 33/00(2010.01)

G 09 F 9/33(2006.01)

【F I】

G 09 F 9/00 338

H 01 L 33/00 H

H 01 L 33/00 L

G 09 F 9/33

【手続補正書】

【提出日】令和4年1月28日(2022.1.28)

20

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ウエハ上に形成されてから、互いに分離した、電極を有する多数のチップ部品を、前記電極側を保持する第1転写基板に転写した後に、

前記電極の反対側を保持する第2転写基板に転写してから、

個々のチップ部品を配線基板の所定位置に対向配置した状態で、前記チップ部品に前記第2転写基板越にレーザー光を照射して、前記チップ部品を前記配線基板に転写配置して実装する実装方法であって、

前記第2転写基板内を、複数のエリアに区分けし、個々のエリアに応じた位置情報を基に前記チップ部品を転写配置する実装方法。

【請求項2】

請求項1に記載の実装方法であって、

前記第2転写基板上のチップ部品配置を観察して得たデータを用いて、前記エリア毎の位置情報を設定する実装方法。

【請求項3】

請求項1または請求項2に記載の実装方法であって、多数のチップ部品を第1転写基板から第2転写基板に転写する際に、加圧する工程を有する実装方法。

【請求項4】

前記チップ部品としてLEDチップを、前記配線基板としてTFT基板を用い、

請求項1から請求項3の何れかに記載の実装方法を用いて画像表示装置を製造する、画像表示装置の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

40

50

**【補正の内容】****【0018】**

上記課題を解決するために、請求項1に記載の発明は、  
ウエハ上に形成されてから、互いに分離した、電極を有する多数のチップ部品を、  
前記電極側を保持する第1転写基板に転写した後に、前記電極の反対側を保持する第2転  
写基板に転写してから、個々のチップ部品を配線基板の所定位置に対向配置した状態で、  
前記チップ部品に前記第2転写基板越にレーザー光を照射して、前記チップ部品を前記配  
線基板に転写配置して実装する実装方法であって、  
前記第2転写基板内を、複数のエリアに区分けし、個々のエリアに応じた位置情報を基に  
前記チップ部品を転写配置する実装方法である。

10

**【手続補正3】****【補正対象書類名】明細書****【補正対象項目名】0019****【補正方法】変更****【補正の内容】****【0019】**

請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の実装方法であって、  
前記第2転写基板上のチップ部品配置を観察して得たデータを用いて、前記エリア毎の位  
置情報を設定する実装方法である。

20

30

40

50